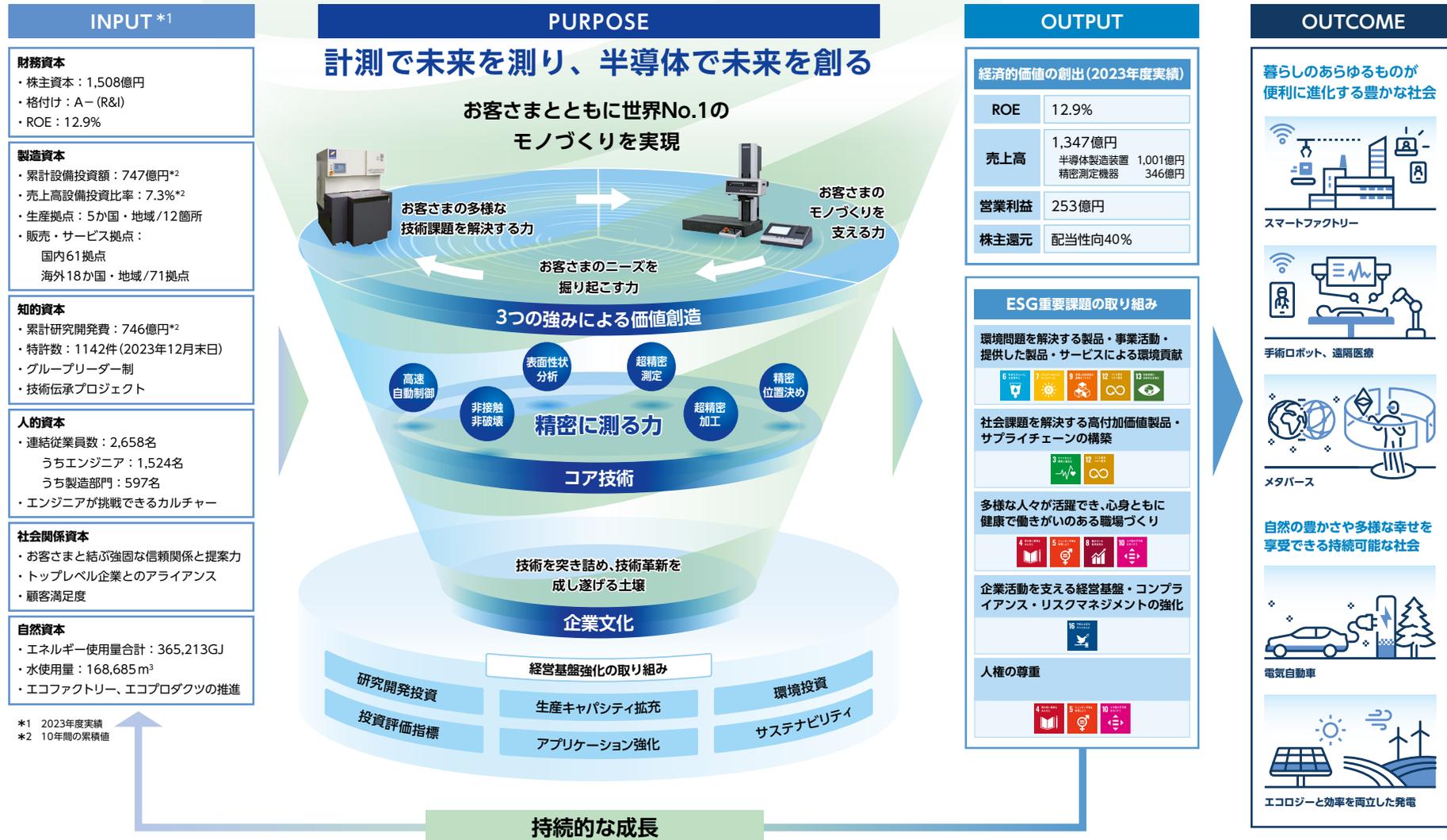


価値創造プロセス

東京精密グループには、「技術を突き詰め、技術革新を成し遂げる土壌」が脈々と受け継がれ、コア技術を源泉とした6つの要素技術として結実しています。コア技術と当社の3つの強みによる相乗効果によってビジネスの成長を推進し、東京精密グループのビジネスモデルが今後も進化し続けることで、「暮らしのあらゆるものが便利に進化する豊かな社会」と「自然の豊かさや多様な幸せを享受できる持続可能な社会」の実現につながると考えています。



東京精密の競争力の源泉

東京精密グループは、お客さま、取引先、従業員など多くのステークホルダーと共にWIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ることを目指しています。コア技術である「精密に測る力」を軸とし、当社グループに深く関わる5つの資本を競争力の源泉に、「志」を共にする皆さまと技術、知恵、情報を融合することで、東京精密グループの3つの強みを築き上げています。

WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう

お客さまのニーズを掘り起こす力

お客さまの多様な技術課題を解決する力

お客さまのモノづくりを支える力

“ACCRETECH” 「志」を共にする幅広い人々とともに、互いが持つ技術、知恵、情報を融合

	 製造資本 自社で内製化可能な生産体制	 知的資本 ニーズ・シーズの知見を結集し、高い技術力で新製品を開発するノウハウ	 人的資本 お客さまのモノづくり支援を実現する人財	 社会関係資本 価値共創の基盤となるお客さま、取引先とのネットワーク	 自然資本 省エネ・省資源に資する技術力
強み・特徴	機械加工・製造・検査・出荷まで一貫した内製化による自社生産	自社工場に人財と最先端設備を集中し、開発から製造まで迅速に商品化	製造・技術・サービス・営業が一体となりお客さまに向き合い、協力して高品質なサービスを提供	お客さま、取引先との強固な信頼に基づく共創による価値創造	提供する製品のライフサイクルを含むバリューチェーンについて環境負荷を低減
競争力の源泉	<ul style="list-style-type: none"> 一貫して内製可能な技術および設備(営業、技術、工場が一体となった生産体制) メイン拠点とアッセンブリ拠点をもち、柔軟な生産体制を整備 国内外拠点で機動的にサービスできる体制 	<ul style="list-style-type: none"> 高精度、高速な精密加工技術 幅広い課題解決に対応するアプリケーション力 グループリーダー制のもと迅速な開発を実現 高い特許査定率およびパテントスコア 技術伝承プロジェクトの推進 	<ul style="list-style-type: none"> エンジニアがチャレンジできる企業文化 モノづくり・開発・サービスに精通した経験豊富なエンジニア 高い商談力とお客さまからの厚い信頼を得た営業力 お客さまの幅広いニーズにワンストップで対応できるカスタマーエンジニア 	<ul style="list-style-type: none"> お客さまとの強固な信頼関係(技術・生産標準に組み込まれた実績の数々) トップレベル企業とのアライアンス、ブランドライセンス、共同開発 サプライヤー、ビジネスパートナーとの強い関係(ACCRETECH会、協力会) 	<ul style="list-style-type: none"> 低炭素・省資源なエコファクトリーの構築による環境負荷の低減 エネルギーロスの少ない環境配慮型製品の開発によるエコプロダクトの推進

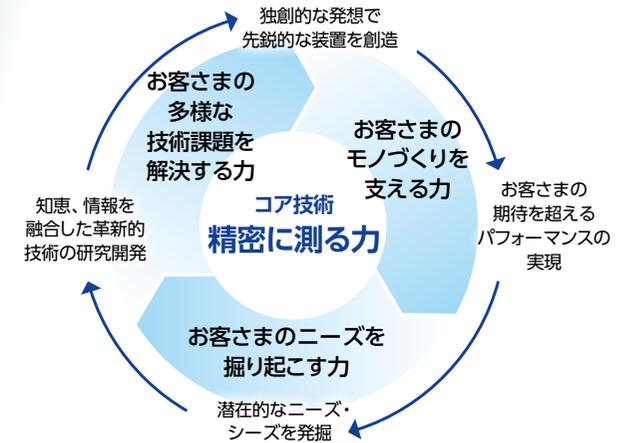
コア技術：精密に測る力

東京精密のビジネスモデル

磨き上げたコア技術「精密に測る力」と3つの強みにより 徹底したお客さま目線で実直にモノづくりの課題を解決します

東京精密グループは「精密位置決め」「超精密測定」「超精密加工」など「測る」に関する独自の技術により、精密測定機器事業と半導体製造装置事業の両輪で半導体や自動車などを生産するお客さまのモノづくりを支えています。

日々お客さまの側で声を聞く中で、時にまだ誰も解決していないニーズ、シーズを深掘りし、経験豊富なエンジニアたちの知恵と経験を結集し、革新的な装置を開発してまいります。技術への飽くなき探究心と、徹底したお客さま志向が東京精密の強みです。



東京精密のコア技術



当社製品はコア技術である「精密に測る力」を源泉としていくつかの要素技術によって構成されています。

精密に測ることによって、位置決めや超精密加工、高速自動制御のためのフィードバック、あるいはさらに進化させた超精密測定へと領域を広げています。アプリケーションによっては非接触・非破壊で対応する要素技術にまで展開しています。

また、測ることによってその計測データから対象物の性状を合否識別するアルゴリズムなど、ソフトウェアにおける要素技術として発展させています。

東京精密の3つの強み

強み 1

お客さまのニーズを振り起こす力

お客さまとの強い信頼関係のもと、お客さまの多様なニーズを早期に把握

差別化ポイント

- お客さまの多様な要望をキャッチする力(問題発見能力、わずかなサインを察知する能力)
 - ▶技術・製造・営業・カスタマーエンジニア(CE)が一体となってお客さまニーズを把握する体制
- 幅広いお客さまニーズを形にするソリューション力
 - ▶グループリーダー制のもと技術が中心となりマーケティング・企画

強み 2

お客さまの多様な技術課題を解決する力

コア技術を新たな市場やお客さまの視点に活用し、独自の技術開発力で革新的な機能を創出

差別化ポイント

- エンジニアが新しいことにチャレンジできるカルチャー
- 難易度の高い機能要件を実現できる経験豊富なエンジニア(高い「技能」を有するエンジニア)
- 匠の技術継承と匠の技の標準化(品質管理ノウハウの継承と形式知化)
- 電気制御技術、設計手法などに組織横断で横串を通す標準化委員会

強み 3

お客さまのモノづくりを支える力

高い技術力のもと、お客さまの生産能力の最適化と最大化をサポート

差別化ポイント

- カスタマーエンジニアとお客さまの深い信頼関係(お客さまの懐に飛び込む、本音を話せる関係によるWIN-WINの関係構築)
- お客さまフィールドにおけるカスタマイズにより、装置パフォーマンス最大化を支援
- 素早いレスポンス、お客さま第一のサポート体制
- 優秀なカスタマーエンジニアの育成と、装置ごとの柔軟なチームワーク体制

持続的成長に向けて

東京精密グループはメガトレンドから想定されるリスクと機会を認識し、持続的な成長を見据えながら中期経営計画およびマテリアリティ(重要課題)を策定し、持続的な成長を実現していきます。



マテリアリティ

東京精密グループは、2022-2024年度中期経営計画に併せて、事業活動のバリューチェーンの状況と環境、社会への影響など配慮すべき課題を整理し、重要課題（マテリアリティ）を見直しました。具体的な取り組みや目標を示し、従業員一人ひとりの取り組むべき課題を明確化し、その業務の価値を理解しやすくすることでモチベーションの向上につなげていきます。

マテリアリティを具体的な活動に落とし込むために、サステナビリティテーマと優先的な取り組みを設定し、サステナビリティ委員会および重要課題対応チーム・分科会において、活動計画を策定・実行しています。サステナビリティ委員会ではマテリアリティに関する報告および評価を実施しており、その結果を受け2023年度に優先的な取り組み事項や計画・目標を見直しました。

事業環境の変化	マテリアリティ	サステナビリティテーマ	優先的な取り組み	活動計画と実績
<ul style="list-style-type: none"> 気候変動 デジタル社会の実現と多様なニーズ・規制 高効率・最適な社会環境・インフラ整備 サステナブルな社会意識 東京精密の現在～将来の事業トレンド 	E 環境 環境問題を解決する製品・事業活動 提供した製品・サービスによる環境貢献	<ul style="list-style-type: none"> 地球温暖化防止 省資源活動 循環型社会の形成 	<ul style="list-style-type: none"> CO₂排出量削減 電力・水・紙使用量削減 環境配慮型製品 飯能工場の節電・節水 	環境マネジメント P44 気候変動に関わる情報開示 P39 エコファクトリー P44 エコプロダクツ P46
半導体製造装置事業 <ul style="list-style-type: none"> Society 5.0の実現に向けた高機能デバイス頭頭 半導体・電子部品の数量増加 脱炭素化に向けたパワー半導体(SiC/GaN)の革新 微細化(2D)の限界に伴う三次元(3D)実装(アドバンスパッケージ)拡大 	S 社会 社会課題を解決する高付加価値製品 サプライチェーンの構築 多様な人々が活躍でき、心身ともに健康で働きがいのある職場づくり 人権の尊重	<ul style="list-style-type: none"> 製品責任 調達リスクの軽減 労働環境 安全健康 ダイバーシティ 人財育成 人権の尊重 	<ul style="list-style-type: none"> 品質管理 化学物質管理 サプライチェーンの強化 健康と安全の向上 ダイバーシティ推進 人財育成推進 エンゲージメントの向上 人権教育の実施 人権デュー・ディリジェンスの実施 救済システムの構築 	品質 P48 サプライチェーンマネジメント P50 働き方 P52 人的資本戦略 P36 人権の尊重 P54
精密測定機器事業 <ul style="list-style-type: none"> カーボンニュートラルに向けた電動車・電動化技術の市場拡大 製品品質の要求度の高まり(工程内で品質を作り込む・不良品を後工程に流さない) 拡大する成長分野での新たな計測技術のニーズ(半導体、航空機、医療分野など) 	G ガバナンス 企業活動を支える経営基盤 コンプライアンス リスクマネジメントの強化	<ul style="list-style-type: none"> 事業の持続的成長 競争力向上 公正・透明、迅速な企業活動 贈収賄・腐敗防止 災害などへの危機管理 	<ul style="list-style-type: none"> 内部統制機能 企業倫理・法令遵守 適時、適切な情報開示 健全な内部通報制度運営維持 コンプライアンス教育 事業継続計画 	コーポレート・ガバナンス P61 コンプライアンス P66 リスク管理 P70

● マテリアリティの特定プロセス

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
東京精密のサステナビリティの考え方を整理	バリューチェーン上のビジネスリスク・機会、社会価値で抽出	STEP 2の抽出結果をもとに <ul style="list-style-type: none"> 地球環境やステークホルダーへの影響で評価・順位付け 当社の価値創造・経営戦略との関連性で評価・順位付け 	STEP 2とSTEP 3の結果から、パーパスおよびビジョンを実現するためのマテリアリティを抽出 <ul style="list-style-type: none"> 2022年5月に開催の取締役会・重要案件会議において審議・承認

2022-2024年度中期経営計画

中期経営計画の概要

「仮想空間と現実空間の融合」による世の中の変化を掴み、業容を拡大する

5G (第5世代移動通信システム) による通信技術の急速な進歩によって、仮想空間と現実空間の融合を意味する Society 5.0の世界がさらに広がっていくものと考えられます。この技術の融合には、半導体が深く関連していることから、今後の半導体市場は金額・数量ベース共に大幅に成長し、半導体の大量生産・大量消費の時代が訪れるものと想定しています。この「仮想空間と現実空間の融合」による世の中の変化を掴む取り組みを進めることで、業容の拡大を目指します。

カーボンニュートラルへの対応で、新たな事業機会を獲得する

カーボンニュートラルに向け、NEV、再生エネルギーなどの需要が急速に増えているほか、超高効率の次世代パワー半導体への対応や、新たな測定需要の喚起が進むと想定しています。これらカーボンニュートラルへの対応を進めていくことで新たな事業機会を獲得し、業績の拡大を目指します。

全社戦略

東京精密グループ全体では、研究開発投資の継続、生産キャパシティの拡充、アプリケーション能力の強化を推進します。

またサステナビリティ活動をより強化し、2030年のCO₂排出量を2018年度比で50%削減させる取り組みを進めるなど持続可能な社会への貢献に努めます。

● 全社取り組み

研究開発投資	・ 先端技術、顧客ニーズ対応開発を強化
生産キャパシティ拡充	・ 飯能工場稼働 (2023年度) ・ SPEキャパシティ 年1,400億円+α ・ 次の工場投資も検討
環境投資	・ 2030年CO ₂ 排出量50%削減(2018年度比)に向け必要な投資を検討
投資評価指標	・ 社内評価基準にROICを検討
アプリケーション強化	・ 各国拠点におけるデモ設備強化
サステナビリティ	・ 透明性が高く、環境を意識した経営

全社取り組みに対する見通し

当社は、中期経営計画の定量目標の達成には、そのために必要な全社の取り組みを、足元の景況感にとらわれることなく進めていく必要があると考えています。2023年度は、キャパシティ拡張の一環として飯能工場(埼玉県飯能市)を稼働させ、生産キャパシティを中期経営計画の達成に必要な水準まで高めたほか、ROIC(投下資本利益率)によるセグメント別の評価を開始するなどの取り組みを進めました。これらの取り組みは、定量目標の達成に寄らず、一定の成果が得られる見込みです。

定量目標に対する進捗と見通し

中期経営計画の2年目となる2023年度は、高い受注残高を背景に、引き続き高水準の実績となったものの、4期ぶりの減収、減益となりました。

中期経営計画の最終年度となる2024年度は、半導体製造装置部門では、受注面では生成AIに関連したHBM(広帯域

メモリ)や半導体パッケージ向けの装置需要の維持、拡大が期待されます。さらなる本格的な市況回復に必要な民生エレクトロニクス製品の需要回復、これに伴う半導体、電子部品生産設備の稼働率上昇、半導体ウェーハならびにデバイスの在庫調整の進展なども期待されており、そのタイミングを待っている状況です。精密測定機器部門の事業環境の先行指標となる工作機械受注動向はおおむね2023年度比同水準が予想されるものの、NEVや半導体等、当社グループが注力する分野では緩やかな市況回復を見込んでいます。また、二次電池用の充放電試験システムでは、国内の新たな電池開発向け需要の拡大が想定されます。さらに、国内需要を喚起する政府補助金政策に関連した各種製造業からの汎用計測機器需要が増加すると考えられます。

当社は、これらの事業機会を捉え、中期経営計画の達成に向け、事業を進めてまいります。

● 2024年度 定量目標

ROE	15%以上
売上高	1,700億円 (半導体1,320億円/計測380億円)
営業利益	375億円 (営業利益率：22%)

	(億円)			
	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度 (目標)
売上高	1,307	1,468	1,347	1,700
営業利益	283	345	253	375
営業利益率	21.7%	23.5%	18.8%	22.0%

2023年度の主な取り組みと成果

2023年度は、減収、減益決算となったものの、中期経営計画達成のために必要な取り組みを、計画通り実行しました。

研究開発面では精力的な開発投資を進めたほか、新工場により生産キャパシティの拡充を進めました。また、環境投資に関する取り組みを強化し、工場で使用する電力に起因したCO₂排出量の分析を新工場竣工も踏まえ包括的に行ったほか、開発する製品単位での消費電力削減などに取り組みました。

また、事業セグメント別の投資評価指標としてROICを導入し、2022年度に社内での計算手法を策定し、2023年度にはこれを用いたROICを算出し、継続的な評価を行える体制を整えました。アプリケーション評価の面では、海外現地法人を中心に、デモセンター機能を高める取り組みを進めました。

並行して、サステナビリティへの取り組みを進めました。この結果、MSCIによる当社へのレーティングがBBB→Aへ上方修正されました。

● 主な取り組みおよび結果

研究開発投資	<ul style="list-style-type: none"> ・精力的な開発を実施 ・アプリケーションダイシングマシン、プロービングマシン・ダイシングマシン新機種、Hybrid Bonding用グラインダ等などを展開
生産キャパシティ拡充	<ul style="list-style-type: none"> ・飯能工場稼働(2023年7月) ・八王子工場のスペース再活用を含め、SPEキャパシティ 1,400億+α の水準を達成 ・次期中期経営計画を見据え名古屋工場の建設着手
環境投資	<ul style="list-style-type: none"> ・工場使用電力とCO₂排出量の分析 ・各製品のLCAの削減(消費電力削減、スループット改善)
投資評価指標	<ul style="list-style-type: none"> ・事業セグメント別 ROIC評価を開始
アプリケーション強化	<ul style="list-style-type: none"> ・主要拠点でのデモセンター機能の強化
サステナビリティ(ESG取り組み強化)	<ul style="list-style-type: none"> ・ダイバーシティ強化(女性・障がい者雇用増加他) ・人権デュー・ディリジェンスおよび評価実施 ・MSCI BBB→A, FTSE 3.4 維持

生産キャパシティ拡充

2023年7月、埼玉県飯能市に建設していた飯能工場が、計画通り稼働を開始しました。また、これに合わせて、東京都八王子市の本社工場の最適化を行い、プロービングマシンの生産を中心に、生産キャパシティが50%増加し、中期経営計画の達成に必要と考えられるキャパシティ(半導体製造装置で年1,400億円+α)を確保しました。

また、半導体製造装置、特にグラインダの需要拡大を見据え、愛知県名古屋市の新たな工場を着工しました。この工場は2025年度に稼働する予定です。



飯能工場(埼玉県)
2023年7月稼働
プロービングマシン中心の
生産体制



名古屋工場(愛知県)
2025年度稼働予定
グラインダ中心の生産体制

サステナビリティ

サステナビリティの観点では、女性活躍や障がい者雇用の拡大など、ダイバーシティに関わる取り組みを強化したほか、従業員に対するエンゲージメントサーベイ、人権方針の制定・開示など、企業価値を高めるための取り組みを進めました。

こういった取り組みにより、MSCI社のESGレーティングは、7段階中4段階目のBBBから、同3段階目のAに格上げとなりました。

今後の成長機会への取り組み

2024年度の中期経営計画の達成の前提となるSociety 5.0の世界のほか、さまざまな成長機会を想定しており、2025年度以降の成長機会も多いと考えています。

特に、半導体製造装置事業における、ハイブリッドボンディングの普及、検査装置(プロービングマシン)の高精度温度制御による付加価値の拡大、炭化ケイ素(SiC)半導体の基板加工需要からデバイス加工需要への変化、半導体と計測の融合によるシナジー効果、ならびにNEVバッテリー測定需要は、大きな成長機会と捉えており、2024年度以降の成長にも寄与するものと考えています。

● 今後の成長機会

プローバ高精度温度制御 → 付加価値の拡大

SiC加工は基板主体からデバイス主体へ

Hybrid Bondingによる研削装置の成長

AI関連の需要増加

地政学の変化による需要の増加

NEVバッテリーの飛躍的な個数成長

半導体と計測の融合によるシナジー効果
2025年130億円超

CFOメッセージ

投資は次の成長ステージへの布石



代表取締役副社長CFO
川村 浩一

業績の推移と進捗

2023年度の当社グループの連結売上高は1,347億円で、2022年度にこそ及ばなかったものの歴代二位の高水準となりました。2022年度にはコロナ禍による巣ごもり需要や半導体の国産化を急ぐ中国需要、半導体不足などが追い風となって当社グループ製品への需要が急速に拡大しましたが、2023年度はその反動減もありスマートフォンなどの民生用途向け半導体の需要が冷え込む一方で、生成AI関連需要とEV（電気自動車）などの電源IC用SiC（炭化ケイ素）基板関連の需要が急激に高まり、中国需要の継続も業績を押し上げました。2022年度と2023年度では歴代一位と二位でも内容が違い、むしろ2022年度の方ができ過ぎだった印象です。

2024年度は、足元は2023年度に続き民生需要が戻らず、その低迷は長引かないとも限りません。一方で、生成AI関連需要は強く、メモリなどでも一部在庫水準が底打ちしています。そうした技術トレンドを取り込んで、中期経営計画目標の連結売上高1,700億円達成に向け、最後まで気を抜かずに行っていこうと思います。

財務の基本的な方向性

ともあれ、半導体需要は今後も拡大の一途を辿ると見込まれます。ただし半導体産業には作れる時に一気に作るという特性があるため、景況感の振れ幅が大きい。それに対応するには、資本とキャッシュを手厚く持っておく必要があります。目処としては自己資本比率70%、キャッシュは運転資金・固定費の半年分は持っておきたいところです。

設備投資については、長い間年間25億円～30億円程度で推移していました。当社製品は労働集約的な多品種生産の傾向が強く、大きな設備投資が必要なかったためです。しかし現在、半導体産業は“坂の上の雲”のような状態にあり、当社グループも生産キャパシティ拡大が必要となっています。そこで2018年度以降は、毎年100億円近くの設備投資を行ってきました。

それでも2022年度には、急激な受注増をこなし切れず受注残が積み上がり、それに伴い仕掛品が増えました。さらに今後の生産能力増強への備えやリードタイムの長いグライндаの売上拡大、物流難の中での原材料積み増しもあり、在庫が増えてキャッシュを圧迫しています。加えて、お取引先さまを支援するために買掛金の回収サイトを短縮したこともあってキャッシュコンバージョンサイクルは伸び、キャッシュフローに負荷が掛かっている状態です。神経を使う状況ではありますが、設備投資で増えた生産キャパシティが売上、利益、キャッシュへとつながる循環に入っていく日は近いと確信しています。また、売掛金のサイト短縮化にも取り組んでいる途中です。

アロケーション

アロケーションについては、営業利益の4割*+減価償却費を原資として運転資金や設備投資を賄っていく方針です。うち設備投資は、EBITDA（営業利益+減価償却費）の25～50%を目途としています。今期は、名古屋新工場の建設などに約95億円を投じる予定です。ERP（基幹業務システム）の一部改修やセキュリティに対する投資も予定しています。

* 営業外収益や特別損益をゼロとした場合、営業利益＝税引前当期純利益。実効税率を30%、配当性向を40%とすると、手元に残るキャッシュは営業利益の42%。

CFOメッセージ

また、試験研究費については上記原資の範囲外ではありますが、競争力の源泉たる投資と認識しています。中期経営計画では対売上高比10%を目処としていますが、これは上限ではなくむしろ目指して欲しい、という意味。現状は7~8%ですが、10%に達したらさらに増やしても良いと思っています。試験研究費で最大の費目は人件費ですので、もっと多くの人材を迎え入れられる環境・体制の整備も必要です。

なお、フリー・キャッシュフローは2022、2023年度と2期連続でマイナスとなりました。主な要因は設備投資で、在庫増による運転資金増も影響しました。今は“坂の上の雲”を捉えるための助走期間ですので、歯を食いしばってでも必要な資金は出し続けます。

次期中期経営計画でも、生産キャパシティの拡大は大きな戦略テーマとなるでしょう。次のステージに向けた布石であり、投資が実を結べば大きな成長が待っています。私は当社に入社して20年弱になりますが、今が一番ワクワクしています。

<中期キャッシュ・アロケーション目途>

試験研究費	売上高試験研究費比率 10%以内
設備投資	通常時：EBITDA 25%以内 Max時：EBITDA 50% (EBITDA = 営業利益 + 減価償却費)
株主還元	配当：配当性向 40%を目安に実施 投資動向などを勘案し自己株式取得
M&Aなど	FCFマイナスにならないよう配慮

●財務・株主還元

<基本的な考え方>



ROICとROE

ただ、投資する以上は、費用対効果をきちんと見極めねばなりません。そこで当中期経営計画の開始とともに導入を始めたのがROICです。初年度の2022年度に計算方法を確立し、2023年度には事業別のROICやWACC（加重平均資本コスト）も算出できるようになりました。いずれはROICツリーに分解し、売掛金回収サイクルや在庫回転率、設備稼働率など従業員が実感できるさまざまな指標に細分化し、グループ内において、収益性、効率性、採算性を計測するために役立てたいと考えています。

飯能工場に設備を入れたタイミングで算出したところ、分母の投下資本が大きくなったためROICがストーンと落ちました。投資とはどういうことかが分かる事例で、こうした変化を測定できるインパクトは大きいです。今後は投資対効果を上げていくことでROICの回復、向上を実感できることになると考えています。

一方、開示指標としては、ROE（自己資本利益率）を使い続けます。株主目線の指標で、資本効率を追えるためです。現状の目標はROE15%。2023年度にはROEが少し下がりましたが、株主資本コストは継続的に十分上回っており、目標との関係は3~5年の中期的なスパンで見ただけであればと思っています。主に営業利益の額と率の向上を通じて改善を図る方針です。

株主還元とIR

株主還元については、配当性向40%を必ず実施することが主軸です。2022年度、2023年度には自己株式取得も行いました。基本的にはキャッシュの創出状況を見て判断しますが、現状は設備投資を行って将来キャッシュフローを何倍にもしたいところです。

PBR（株価純資産倍率）を見ると、市場から一定の評価を得られていると考えます。株主資本コストを大きく上回るROEを実現しており、これが一定の評価につながっていると考えています。ただ、業界的に業績のボラティリティは高めなので、そこはIRによって当社をより深く知っていただくことが大切だと考えています。サステナビリティへの取り組みを含め、株主・投資家さまには十分ご理解をいただかないと資本コストが上がってしまいます。実直に開示に取り組み、当社の最新状況を良い時も悪い時も漏らさず知っていただき、将来の安定成長への糧とする考えです。

事業別戦略

半導体製造装置事業

事業概要

半導体製造装置事業では、ウェーハ上に形成されたチップの電気的特性を試験するプロービングマシン、ウェーハからチップを1個1個分離するダイシングマシン、ウェーハの薄片化や平坦化を行うグラインダなどを提供しています。

半導体デバイスや電子部品の微細化・複雑化が進む中、より詳細に電気的な特性を評価するためのプロービングマシン、より高品質な半導体デバイスの製造に必要なダイシングマシン、グラインダに対する重要性が高まっています。



PG3000RM II



AP3000

市場トレンド・事業機会

変化する世の中のニーズに合わせて、半導体の進化のスピードはますます加速しており、当社にとってこの潮流は、大きな事業機会になるものと考えています。

まず、脱炭素社会の実現に向け、電流を制御するために使われるパワー半導体では、通常のシリコンだけではなく、加工が困難な炭化ケイ素(SiC)を材料に使った製品も増えています。当社はこれに適した多様な研削装置(グラインダ)を有しており、今後の需要拡大が期待できます。

次に、Society 5.0(仮想空間と現実空間の融合)の実現に向け、高機能デバイスの台頭や、半導体・電子部品の数量そのものの増加が想定されます。加えて、半導体デバイスの検査難度が増すほか、検査時間の増加が考えられ、特に当社の検査

装置(プロービングマシン)では、強みであるカスタマイズ力により、こういったニーズに対応できるものと考えています。

最後に、微細化の限界に伴う三次元実装の拡大によって高精度の加工が要求されることから、当社の加工装置においても恩恵があると考えています。三次元実装には、ウェーハ、チップ、基板材料などの高い貼り合わせ加工精度が要求され、加工装置の需要増加につながるものと考えています。

また、昨今生成AIに関連する半導体デバイスの需要期待が高まっております。生成AIに関連するプロセッサやHBMなどのメモリにおいても、高い検査加工精度が求められることから、当社半導体製造装置の事業機会にもつながるものと期待しています。

技術トレンド	機会	該当製品
脱炭素化に向けた パワー半導体(SiC/GaN)の革新	<ul style="list-style-type: none"> SiCなどの難削材加工需要増加 高効率アウトプット・高精度加工の両立 	高剛性研削盤 エッジグラインダ CMP
Society 5.0の実現に向けた 高機能デバイス台頭 半導体・電子部品の数量増加	<ul style="list-style-type: none"> 測定時間増加ならびに検査難度の上昇 検査に関する付加価値の上昇(温度対応、スループット改善) 高精度加工の需要増加 高効率アウトプット・高精度加工の両立 	プロービングマシン ポリッシュ・グラインダ アブレーションレーザーダイシングマシン 計測ビルトインモデル
微細化の限界に伴う 三次元実装(アドバンスパッケージ)拡大	<ul style="list-style-type: none"> 高精度研磨加工の需要増加 高効率アウトプット・高精度加工の両立 貼り合わせ加工の精度要求の高まり テスト工程数の増加 	ポリッシュ・グラインダ エッジグラインダ ブレードダイシングマシン プロービングマシン

中期経営計画の進捗と今後の施策

2023年度の半導体製造装置部門では、期を通じスマホ、PC、テレビ等の民生エレクトロニクス製品の需要が低迷したことにより、ロジック半導体や電子部品向け需要が軟調に推移したほか、前期堅調だったウェーハ増産向けの装置需要も減少しました。

生成AI関連向け需要が一定の下支えとなったものの、受注高は前年同期比減少しました。

売上面では、おおむね顧客要求納期に沿った出荷を進めることができ、既往ピークの前期売上高は下回ったものの、引き続き高い水準を収めることができました。地域別には、検査工程向け装置は中国・韓国、加工装置は日本・台湾等で堅調でした。

中期経営計画の最終年度となる2024年度の半導体製造装置部門の業績は、受注面では生成AIに関連したHBM（広帯域メモリ）や半導体パッケージ向けの装置需要の維持、拡大が期待されます。さらなる本格的な市況回復に必要な民生エレクトロニクス製品の需要回復、これに伴う半導体、電子部品

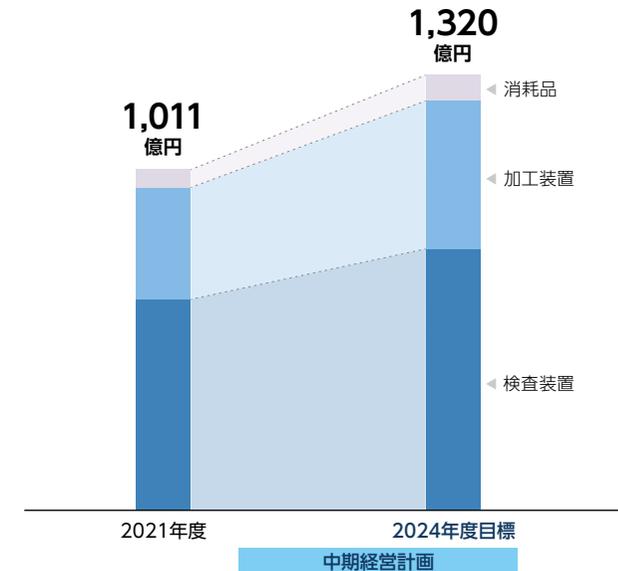
生産設備の稼働率上昇、半導体ウェーハならびにデバイスの在庫調整の進展なども期待されており、そのタイミングを待っている状況です。一方で、半導体デバイス微細化の限界に伴うアドバンスパッケージ・三次元積層に関連した技術革新投資、各国の補助金政策に伴う投資が本格化するものと想定され、当社製品の需要は中長期で拡大するものと見込まれます。

当社は、これらに関連した顧客要求に応える製品ならびにオプション機能の開発を進めるほか、市況の急回復に備え、製品部材の先行調達や生産ラインの準備を進め、業容拡大に努めてまいります。

	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度 (目標)
売上高	1,011	1,124	1,001	1,320
営業利益	247	299	199	—
営業利益率	24.4%	26.6%	19.9%	—

(億円)

● 製品別売上構成比



加工装置：ダイシングマシン、グラインダ
検査装置：プロービングマシン

2023年度総括	今後の戦略
消耗品 ・全般に軟調も、研削系消耗品需要拡大で横ばい維持	・消耗量が多いSiC向け砥石需要の取り込み、強化
加工装置(ダイシングマシン・グラインダ) ・SiC向け/ウェーハ用に高水準の需要 ・アブレーションレーザダイシングマシン販売開始	・SiC/GaN、アドバンスパッケージ向けウェーハ用グラインダ強化 ・アブレーションレーザダイシングマシン販売推進
検査装置(プロービングマシン) ・高付加価値分野に注力、デパート化推進による用途拡大(HPC、パッケージ、メモリ、パワーデバイスなど)の実行	・ハイエンド分野で高付加価値を提供
長期戦略に基づく半導体×計測シナジー効果 ・計測ビルトインモデル販売開始	・半導体×計測シナジー効果強化

精密測定機器事業

事業概要

精密測定機器事業では、物体の寸法を測定する三次元座標測定機、表面・円筒形状の誤差などを正確に算出する表面粗さ・輪郭形状測定機、工作機械内部で計測を行うマシンコントロールゲージ、バッテリーなどの二次電池の試験を行う充放電試験システムなどを提供しています。

モノづくりにおいて、正しく設計通りに作られるかを確認するために精密測定機器は欠かせません。最近ではカーボンニュートラルに向けたNEV普及による新たな精密測定需要や自動化などの需要も高まっています。



SURFCOM NEX 200 DX2/SD2



ACCesS
エネルギーゲージ式
充放電試験装置

市場トレンド・事業機会

カーボンニュートラルに向けた電動車・電動化技術の市場拡大が想定されます。物の長さ・丸さ・粗さなどを測る物理計測に加えて、電気計測、内部欠陥などの評価が求められ、充放電試験システムなどの成長も期待できます。

また、高精度検査需要そのものの拡大のほか、製造工程の自動化によるインライン計測、工作機械などの加工機用センサの成長が見込まれます。

さらに、モノづくり市場そのものが拡大することで、自動車以外の分野でも半導体、航空機、医療などの新たな計測技術のニーズの拡大が想定されます。

EV向けのバッテリーに注目が集まる中、日本国内でも政府の後押しを受けた研究開発が進み、バッテリー試験に関する事業機会が拡大しつつあります。

こうした状況から、この事業の機会拡大と、当社精密測定機器事業のシナジーを最大化することを目的に、当社連結子会社である株式会社アクレーテック・パワトロシステムの充放電試験システムを親会社へ事業譲受し、中長期的な成長につなげることにしました。

技術トレンド	機会	該当製品
カーボンニュートラルに向けた電動車・電動化技術の市場拡大	<ul style="list-style-type: none"> 計測需要の変化 高精度長さ計測、電気計測、内部欠陥／不純物評価 	各種高精度計測機器製品群 充放電試験システム X線CT装置
製品品質の要求度の高まり(工程内で品質を担保し、不良品を後工程に流さない)	<ul style="list-style-type: none"> 全数検査・現場計測需要の拡大 自動化対応、プロセスコントロール、ネットワーク／稼働監視 	インライン用三次元座標測定機 工作機械などの加工機用センサ データ管理ソフトウェア
拡大する成長分野での新たな計測技術のニーズ(半導体、航空機、医療分野など)	<ul style="list-style-type: none"> 非接触測定技術の需要拡大 高分解能、高速を実現する非接触センサ技術 	白色干渉顕微鏡 非接触距離センサ 各種計測機用非接触レーザ/画像センサなど

中期経営計画の進捗と今後の施策

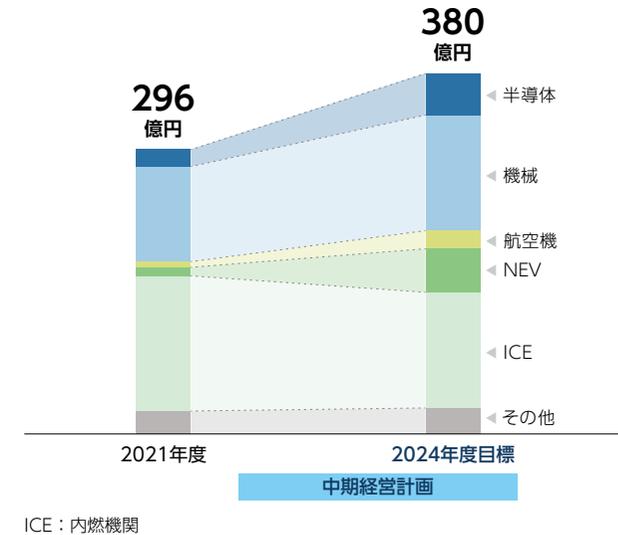
2023年度は、精密測定機器部門でマクロ経済の不透明感や中国の景気減速などを背景に、製造業全般で設備投資先送り傾向が期を通じて続きました。しかしながら、二次電池用の充放電試験システム、EV用のモータなどの基幹部品向け汎用計測機器、航空機・ロボットなどの非自動車向け接触・非接触各種計測機器の販売を強化したことに加え、一部製品の価格改定を行ったことにより、受注高は前期比若干減少したものの、売上高は前年同期比とほぼ同水準になりました。

2024年度は、精密測定機器部門の事業環境の先行指標となる工作機械受注動向はおおむね前期比同水準が予想されるものの、NEVや半導体等、当社グループが注力する分野では緩やかな市況回復を見込んでいます。また、二次電池用の充放電試験システムでは、国内の新たな電池開発向け需要の拡大が想定されます。さらに、国内需要を喚起する政府

補助金政策に関連した各種製造業からの汎用計測機器需要が増加すると考えられます。当社グループは、これらの需要獲得に向けた取り組みを進めるほか、中長期的な労働力不足に備えた自動化関連ニーズに対応すべく、ソリューションの提案力強化を図っていきます。

	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度 (目標)
売上高	296	344	346	380
営業利益	36	46	54	—
営業利益率	12.3%	13.4%	15.6%	—

● 製品別売上構成比



	2023年度総括	今後の戦略
半導体向け	・半導体向け非接触計測機器、汎用計測機器の開拓	・半導体向けの需要開拓、ソリューション展開継続
機械・航空機向け	・航空機向け専用機のリリース ・医療向け非接触式計測機器の開発・強化 ・非接触シャフト測定機拡販	・自動化需要に向けた、機器・SW・サービスを含めたトータルソリューション展開
NEV向け	・EVギア・モータなどの部品物理測定、バッテリーX線CT測定需要の開拓 ・充放電電池評価受託サービスはフル稼働維持	・NEV向け計測のトータルソリューション展開
ICE向け	・回復は緩慢も、安定的な需要 ・更新需要案件取り込み	・自動化ソリューション、保守点検業務強化

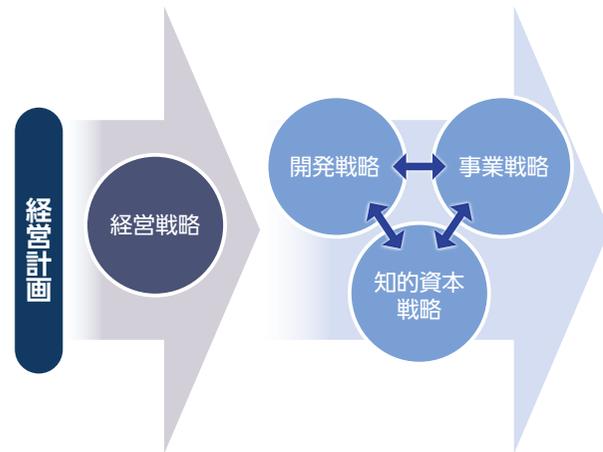
知的資本戦略

知的資本基本方針

知的資本戦略の位置づけ

当社は、無形資産の一つである知的資本を重要視しており、知的資本の充実に向けて積極的に投資を行っています。

知的財産部門は、事業部門および技術部門と密接に連携し、効果的な知的資本戦略を立案・実行することで、知的財産の側面から経営戦略を推進しています。



経営戦略に基づく開発戦略や事業戦略に基づく知的資本戦略を推進

知的資本の拡充

当社は、知的財産権の保有件数が従前から増加傾向にあり、今後もさらに、積極的に権利取得を進め、知的資本の拡充を図ります。また、知的資本の拡充と相関して当社業績が向上していることが確認できます。なお、知的資本の安定的な拡充は、潤沢な研究開発費の予算配分が下支えしていることも確認できます。

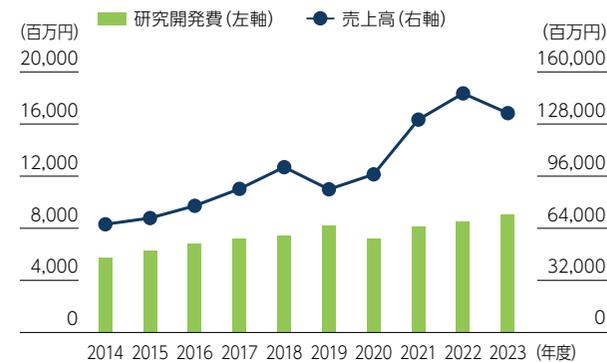
また、外国への展開については、昨今の半導体の自国内生産への流れや今後の経済動向予測を踏まえて知的財産権の各国での取得を進めています。

● 特許保有件数と売上高の関係



* 特許保有件数は各年の12月末日で判定した件数を示しています。

● 研究開発費と売上高



* 売上高、研究開発費は年度末の値を示しています。

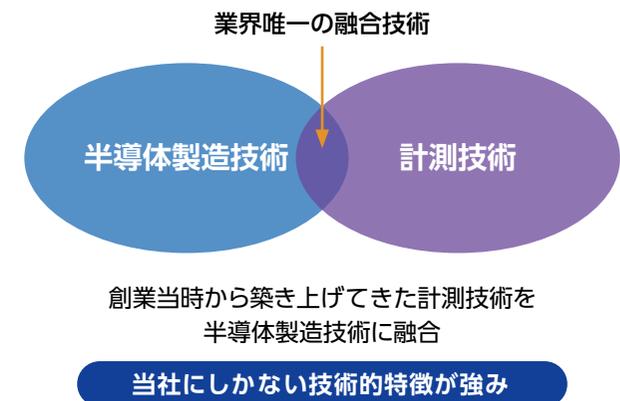
知的資本に対する取り組み

現状分析

知的財産の状況分析としてパテントマップ分析および保有資本の棚卸に取り組んでいます。これを自社コア技術の強さやさらなる強化方針（ポートフォリオの充実化）の策定に活かすほか、他社の知的資本状況を把握し、新規技術分野への展開可能性の探索にも活用します。

また、市場動向や技術動向などの情報と融合させたIPランドスケープに基づき、顧客需要と当社技術の供給可能性とを照合することで、さらに顧客需要にフィットした技術創出を図ります。

当社は、計測技術を半導体製造技術に融合させることができる業界唯一のメーカーです。創業以来培われてきた高い計測技術を半導体製造装置に搭載できることは、当社の大きな強みです。この強みによって、新規顧客の開拓や新規事業領域の開拓、これに伴うアライアンスパートナーやM&Aの対象企業の選定および、知的財産デュー・ディリジェンスなど経営戦略遂行に資する支援を実施しています。

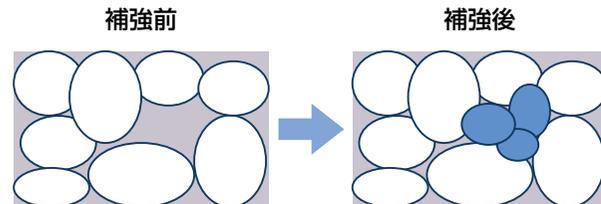


特許網の充実

知的財産の棚卸により自社特許網の現状を把握し、必要に応じて追加で特許取得を行うことにより、理想的な特許網の構築を実現しています。これによって隙のない高い参入障壁を形成し、競争優位性の源泉としています。特に基本特許と位置づける発明は、世界各国に幅広く特許を取得しています。

他方で、秘匿すべき重要な発明については秘密情報として、情報セキュリティ委員会の指導に沿って厳重な情報管理を徹底しています。

また、知的財産権の権利維持の要否判断を技術部門とともに定期的に行い、事業戦略上不要となった権利を放棄することで、過剰な投資を回避しています。



棚卸による自己分析で理想的な特許ポートフォリオを構築(イメージ図)

出願戦略(包括的かつ安定的な権利の取得)

技術開発活動を通じて生まれる発明を漏れなく適時に特許出願ができるよう、技術部門と定期的に発明相談会を開催し、発明者が発明と認識していない発明まで発掘を行っています。

また、安定性が高い瑕疵のない権利を取得できるよう実施形態や実験データの充実など出願明細書の品質向上に努めます。さらに審査対応において不要な限定補正や意見主張を控え、広く権利化できるよう日々細心の注意を払い権利化業務に取り組みます。また、類似する発明を複数の観点から出願し、万一、その一部が無効化されたとしても実質的に発明の保護が維持できるように権利の安定性を高めています。

また、当社事業領域外への技術転用を想定した権利化も並行して行い、ライセンスの需要創出を目指しています。

ブランド保護

当社ハウスマークや製品名称やロゴについて世界各国において商標権を取得し、当社ブランドの保護体制を構築しています。また、他社活動による出所混同リスクに対し適時かつ適切に対応できるよう他社商標登録状況を随時監視しています。

また、ドメインについても事業活動地域において各国に幅広く登録を行っています。



デザイン保護

審美性の高い製品デザインやパーツデザインなど技術的側面以外の製品特徴も知的資本として保護しています。知財ミックスにより当社事業を多角的に保護し、知的資本価値の相乗的向上を図っています。



PULCOM W10

インプロセス・ポストプロセス両用指示管制部

知的資本創出の促進

各部門の責任者が集まり未来社会を思考する場を定期的に設け、当社の社会貢献の可能性を模索しています。そして、この取り組みを通じて抽出された課題に対し、次は各部門の担当者が集まりソリューションを検討する場を定期的に設けることで、質の高い特許発明の創出を促進しています。また、この機会には、若手従業員の発意の場でもあり、若手の頃から挑戦できる風土を醸成することで、エンゲージメントの向上および人財育成にも貢献しています。

また、知的創造活動の活性化および知的財産保護の徹底を図るため、職務発明の対価のみならず、優秀な発明をした発明者や業績貢献の大きい特許発明をした発明者に報奨金の支給を行っています。また、会計年度ごとに多数出願した部署や個人に対し発明表彰も行っています。

さらに、開発の成功事例について、功労者から全技術者に対し発表する場を設け、成功までの苦労や挫折およびそれら乗り越えた経緯を共有し、開発意欲を高め、事業推進力の増強とともに、新たな知的資本の創出を招来させる取り組みを行っています。



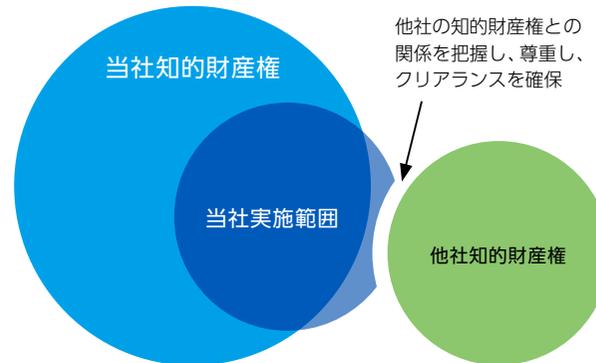
2024年 開発成功事例報告会

他社権利の尊重

製品開発段階ごとに開発審議会を実施し、他社知的財産とのクリアランスを確認し、抵触リスク評価を行っています。これにより知的財産専門スタッフが、開発初期段階から営業活動段階まで参入して、特許、意匠、商標、著作、不正競争防止など幅広く適法な事業活動の支援を行います。

また、当社事業活動に関係する特許公報を常時監視するとともに他社の開発動向を調査し、基礎の開発段階から抵触リスクをヘッジしています。

また、製品取扱説明書やカタログなど当社頒布物への知的財産表記なども適切に記載するよう関係部署と協働しています。



※ 模式図（当社は実施範囲に知的財産権を確保するよう努めております。）

知的財産人財育成

当社の知的財産リテラシー向上のため、職能別に知的財産研修を実施しています。特に、これから多く発明するであろう若手技術者に対しては、技術部門の部署ごとに年数回にわたり基礎研修を繰り返し、新進気鋭な人財からの知的資本創出を促しています。

また、技術部門には、部署ごとに特許をはじめ、製品名称やカタログおよび展示会など、商標、意匠および著作を管理する知財管理責任者を配置しており、部署内の日々の管理や所属従業員のOJTを行っています。

また、発明者は、知財部門と知財管理責任者などとともに特許出願や審査対応を行うことで特許に関する知見を深めています。

さらに、e-learningにより全社的な知財教育も実施しており、知財に関わりの薄い部署についても基礎的な知財知識の習得を促し、知財リテラシーの底上げを図っています。

人的資本戦略

基本的な考え方

東京精密グループのビジョンの実現、ミッションの達成のためには、当社グループ最大の財産である従業員一人ひとりが、夢に向かってその能力を最大限発揮しながら成長していくことが必要です。

そのため当社グループは、「人権の尊重と労働関連法令の遵守」「従業員が安全・健康に働ける職場環境の提供」「従業員の成長を促進し、多様な人財が活躍できる職場の創出」を推進し、働きがいの向上を図っています。

東京精密グループのビジョン・ミッション

<https://www.accretech.com/jp/company/purpose.html>

● 人的資本の基本的な考え方



ビジョン

東京精密グループは“夢のある未来”を築く一員であり続けます。
 半導体社 最先端の技術で高度なネットワーク社会の実現に貢献する
 計測社 “モノづくり革新”を下支えする未来創造カンパニーを目指す

人財育成

従業員一人ひとりの成長は、当社グループが持続可能な成長を続けるうえで不可欠なものであるという考えのもと、人財育成方針を定めています。

<https://www.accretech.com/jp/sustainability/esg/humanresources.html>

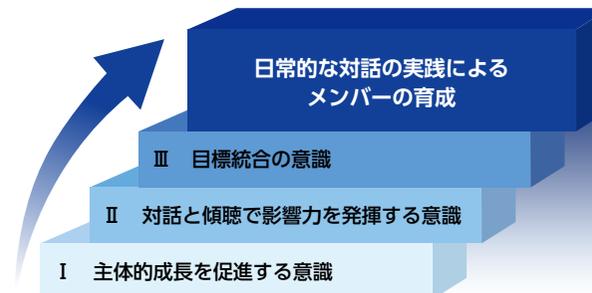
そして、当社の強みである「お客さまのニーズを掘り起こし、多様な技術課題を解決して、モノづくりを支える力」をさらに高め、次世代の担い手とするために、人財育成方針に基づき、さまざまな研修を設け、人財育成に取り組んでいます。

人財育成力の向上

当社では、自律的に成長する従業員の育成に向け、上司に対する「人財育成力研修」を推進しており、研修を通じて「成長を促進する対話力」を身に付けてもらいます。

また、上司が自らの行動を客観的に振り返る機会として、360度フィードバックを年に一度実施するとともに、振り返り研修会も実施しています。

● 人財育成力向上に向けて



お客さま視点での発想力の向上

当社では、お客さま視点に立つことで生まれる新たな気づきをもとに、お客さまの潜在的なニーズを掘り起こし、お客さまの期待を上回るイノベティブな製品・サービスを提供するための研修を実施しています。

本研修はお客さまに共感する力や固定観念にとらわれないイノベティブなアイデアを生み出す力を養うため、デザイン思考の考え方をベースにしています。また本研修は、異なる部署・部門の従業員がお客さまへの価値提供という同じ課題に向き合い一体感を醸成するとともに、部門の垣根を越えた多様な視点を学ぶ場にもなっています。

エンゲージメント

当社グループが、変化の激しい環境の中で大きな成長を実現するためには、従業員がモチベーション高く業務に取り組み、生産性の向上や革新的なアイデアの創出で、お客さまに高い付加価値をお届けすることが重要です。

そのため、当社では、「改善提案表彰」「技術表彰」「新事業企画提案表彰」の制度を設け、会社として創意工夫や新しい取り組みへの挑戦を奨励するとともに、表彰内容を社内報や成功事例報告会を通じて従業員と共有することで、新たな挑戦を促しています。

また、2023年3月より従業員のエンゲージメントの状態を測定するため、エンゲージメントサーベイをスタートしました。サーベイにおいては、エンゲージメント向上の要素として、以下のポイントに関して調査を実施しており、各部門と連携し、職場の実態にマッチするエンゲージメント向上施策を進めていきます。

<エンゲージメント向上の要素>

- ・自らの強みを発揮でき、働きがいを感じられているか
- ・従業員同士が信頼し合い、社内のコミュニケーションが活性化されているか
- ・当社のことをよく知り、当社に対する愛着が湧いているか

ダイバーシティ&インクルージョン

当社は、多様な視点や発想が、互いを刺激しあって新たな価値を創造し、個人の能力の総和を超える相乗効果を得ることができると考えています。そのため、年齢、性別、人種、宗教、出身国、障がいなどを理由とする一切の差別的行為を防止するとともに、多様な人材が、安全・健康で働ける職場の実現に努めています。

そして、従業員一人ひとりの個性が尊重され、自身の持つ能力を最大限発揮でき、やりがいを持って働ける環境を構築していきます。

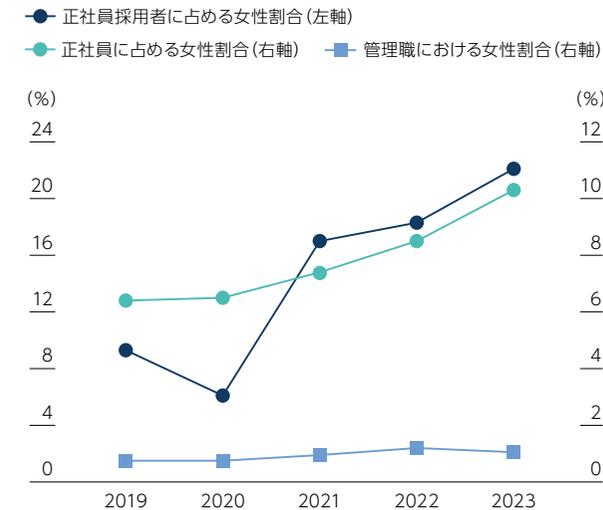
女性活躍推進

当社は、中核人材として働く女性を増やすためには、女性従業員の採用拡大と環境整備が喫緊の課題と考え、「女性活躍推進に関する行動計画」(2021~2025年度)を策定し、2025年度末までに達成すべき目標を設定しました。年々、女性従業員は増加しておりますが、管理職割合は低い状況であるため、女性従業員の活躍に向けた社内の意識醸成やサポートに取り組んでいます。

● 2025年度の目標

採用者に占める女性割合(正社員)	20%
従業員に占める女性割合(正社員)	10%

● 女性活躍推進に関するデータ推移



● 女性活躍推進の取り組み

女性採用

- ・女性採用割合の増加や学生の志望度向上を目的に、若手女性従業員のインタビュー動画を製作し配信。
- ・中途採用での女性採用拡大に向けて、ホームページを大幅にリニューアル。

女性従業員のキャリア開発支援

- ・女性キャリア開発研修の実施。

- ・上司層に対し女性部下育成に関する意識啓発研修を実施。上司が部下との個別面談を通し、各職場での女性活躍推進に取り組んでいます。
- ・外部カウンセリングサービスを2022年4月より導入。(女性に限らず、全従業員利用可能)

障がい者雇用

障がい者の方々方が社会的に自立し、会社へ貢献することを通じて、成長を実感しながら、働きがいをもって就業できる職場づくりに取り組んでいます。ハローワークとの連携や、就労支援機関や特別支援学校などの協力により、個々の適性に合ったさまざまな職場で活躍しています。

具体的な取り組みの一つとして、2023年4月より、各部署が障がい者の特性を活かすことができる業務を切り出し、それらを集約して実施する職場を設置しました。サポート専任者を配置のうえ、障がい者3名で稼働を始め、2024年4月時点で障がい者9名まで拡大しています。事業部門からスキャン業務や組立業務を委託されるなど、会社に大きく貢献しています。

外国籍および中途採用者雇用

当社において中途採用人材は既に欠かせない戦力となっています。また当社は国籍にかかわらず優秀な人材を採用、登用しています。中途採用人材、外国籍人材のいずれも多様な視点や発想および海外との緊密な連携などに大きな力を発揮しています。

当社の管理職における外国籍従業員割合は0.8%、同中途採用者割合は43.7%です。